

Title (en)

METHOD FOR ELECTRICALLY ISOLATING LARGE AREA ELECTRODE BODIES.

Title (de)

VERFAHREN ZUR ELEKTRISCHEN ISOLIERUNG VON GROSSFLÄCHIGEN ELEKTRODEN.

Title (fr)

PROCEDE POUR ISOLER ELECTRIQUEMENT DES CORPS D'ELECTRODE DE GRANDE SURFACE.

Publication

EP 0302946 A1 19890215 (EN)

Application

EP 88902216 A 19880226

Priority

US 1986887 A 19870227

Abstract (en)

[origin: WO8806803A1] Method for electrically isolating large area electrode bodies to facilitate cascade interconnection of semiconductor bodies which may be deposited afterwards includes applying a maskant in a preselected pattern onto a substrate, depositing a conformal layer of an electrically conductive electrode material atop the patterned maskant and removing the maskant and the electrode material deposited thereon by dissolving in a solvent which is substantially chemically inert with respect to subsequently deposited materials to expose at least portions of the substrate and electrically isolate the remaining portions of the electrode material so that selective electrical interconnections may be made between electrically isolated electrode portions. This method substantially eliminates the need for laser or mechanical scribing of semiconductor bodies on a large area substrate.

Abstract (fr)

Dans un procédé pour isoler électriquement des corps d'électrode de grande surface afin de faciliter l'interconnexion en cascade de corps semi-conducteurs qui peuvent être déposés par la suite, on applique un masque d'une configuration présélectionnée sur un substrat, on dépose par dessus le masque ainsi configuré une couche de conformation en un matériau d'électrode électro-conducteur, puis on élimine le masque et le matériau d'électrode par dissolution dans un solvant qui est pratiquement inerte chimiquement par rapport aux matières déposées ultérieurement, afin d'exposer au moins des parties du substrat et d'isoler électriquement les parties restantes du matériau d'électrode de manière à permettre des interconnexions électriques sélectives entre des parties d'électrodes isolées électriquement. Ce procédé permet pratiquement d'éliminer le recours au traçage mécanique ou par laser de corps semi-conducteurs sur un substrat de grande surface.

IPC 1-7

H01L 21/48; **H01L 27/14**; **H01L 31/02**

IPC 8 full level

H01B 13/00 (2006.01); **H01L 21/48** (2006.01); **H01L 27/142** (2006.01); **H01L 29/40** (2006.01); **H01L 31/0224** (2006.01); **H01L 31/04** (2006.01); **H01L 31/046** (2014.01); **H05K 3/14** (2006.01)

CPC (source: EP)

H01L 21/4846 (2013.01); **H01L 31/022425** (2013.01); **H01L 31/046** (2014.12); **H05K 3/143** (2013.01); **Y02E 10/50** (2013.01)

Citation (search report)

See references of WO 8806803A1

Designated contracting state (EPC)

BE DE FR GB IT

DOCDB simple family (publication)

WO 8806803 A1 19880907; AU 1364288 A 19880926; EP 0302946 A1 19890215; JP H01502631 A 19890907

DOCDB simple family (application)

JP 8800211 W 19880226; AU 1364288 A 19880226; EP 88902216 A 19880226; JP 50206088 A 19880226